

青岛东软载波科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 电话采访	
参与单位名称及人员姓名	安信证券 张正阳、胡洋、张鹏 广发证券 李娜、韩东 国泰君安 王彦龙、谭佩雯	
时间	2023年2月20日 15:00-16:30时；2023年2月21日 13:00 -16:30时	
地点	公司	
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：王辉	
投资者关系活动主要内容介绍	采用现场调研方式进行，本次主要内容如下：	
	问：	答：
	1、公司什么时候开始给国网发双模的产品？	公司已经开始给国网供双模产品了。
	2、今年国网有哪些省份开始招标，招标的规模有多大？	目前还没有开始招标。
	3、芯片和模组的招标是否是统一的招标口径？	只招标模组。
	4、海外市场的哪些国家比较好突破？	2022年海外业务持续发展，除乌兹别克斯坦 G3 方案模组，越南无线方案模组持续供货外，东软 G3、G3 双模、1642 窄带低速方案在保加利亚、泰国、印尼、吉尔吉斯斯坦、非洲等国家和地区形成批量订单，市场范围进一步扩大，公司 G3 双模产品多个项目同时出货，现场效果表现出色。和表厂客户的相关合作持续深入并由点及面扩大，和多个客户形成了多市场、多种类的产品合作，科林电气等厂商采用我司通信方案取得 G3-PLC 产品认证，正泰、华立等客户正采用我司通信方案进行 IDIS 认证测试。表明东软载波海外通信方案进一步获得了业内客户的认可和肯定。
	5、海外产品的研发和国网的产品差异化大吗？	海外以窄带、无线方案模组和 G3 双模产品通信方式为主。国网以宽带双模产品为主。
	6、配电网侧目前公司收入规模有多少？怎么看这个市场	目前收入不高，市场前景向好。

	未来的前景？	
	7、公司 MCU 芯片主要的下游应用领域？2023年MCU芯片终端需求展望？	8 位 MCU 主要应用领域为消费电子，如：手机充电宝，充电器，电动工具、额温枪、电动儿童玩具、智能门锁等，32 位 MCU 以家电为主。2023 年随着经济复苏，电子消费领域会有一定增长，带动芯片销量有一定增长空间。
	8、MCU 芯片主要合作的晶圆厂？	主要的晶圆制造供应商为三星、台积电、联电，封装测试的主要供应商为华天、长电、通富微等，上述供应商都是行业内规模较大，技术及质量水平较高的厂商。
	9、2023 年 MCU 芯片价格与毛利率预期？	目前不太好预测。
	10、公司是否能为工商业/园区客户提供整套的智能微电网解决方案？	可以提供。公司能源互联网板块业务围绕智能配电、智能用电、智能微电网及综合能源应用需求，基于公司成熟的高速双模通信技术，推动客户侧各类能源设施与电网的广泛互联和深度感知，业务涵盖配电室智能化、智能台区建设、用电信息采集及深化应用、分布式能源服务、商业用能服务、工业企业及园区用能服务等，具备完整的分布式光伏发电接入方案、小型分布式风电系统集成方案、储能电站系统方案、微电网系统方案、光储充一体化电站整体方案的规划、设计、施工、运维等相关业务。
	11、公司在储能与充电桩业务上是否有相关布局？	公司具备完整的分布式光伏发电接入方案、小型分布式风电系统集成方案、储能电站系统方案、微电网系统方案、光储充一体化电站整体方案的规划、设计、施工、运维等相关业务。基于 HPLC 及双模技术的用电信息采集方案在充电桩有序充电管理上已有批量应用。
	12、智能化板块后续重点的发展方向？	智能化领域，公司提供面向家庭用能场景、建筑用能节能场景、园区用能节能场景，智能电子提供三大类产品和系统：（1）全屋智能类产品和系统：包括智能照明系统、智能遮阳系统、智能安防系统、智能温控系统、背景音乐系统、楼宇对讲系统、语音控制系统、智能家电控制系统、能源管理系统。（2）

		<p>智能建筑类产品和系统：分为政府办公楼智能化、自持型建筑智能化、高校建筑智能化、中小学建筑智能化、各类型酒店建筑智能化、各类型医院建筑智能化等。（3）智慧园区产品和系统：相比全屋智能和建筑智能这两大类产品 and 系统而言，园区智能化更加复杂，需求更加多样化。园区智能化向运营费用和设备安装成本更低、运营安全系数大幅提升、会展活动要求更高盈利、园区建筑更加节能、生产效率更高的方向发展，已经逐渐进入实际需求落地阶段。</p>
附件清单（如有）	无	
日期	2023年2月21日	